

中国集成电路封装行业发展分析及发展战略研究报告(2026-2031版)

报告简介

在中国集成电路产业的发展中，封装测试行业一直保持着稳定增长的势头。特别是近几年来，中国集成电路封装行业在中国产业升级大时代背景下，符合国家战略发展方向，有完善的政策资金支持，国内本土封装测试企业的快速成长；同时，国外半导体公司向国内大举转移封装测试业务，中国的集成电路封装测试行业充满生机。

受行业整体不景气影响，去年全球半导体材料市场营收下滑显著，包括半导体封装材料。根据中国电子材料行业协会统计，2019年中国封装材料市场规模54.28亿美元，同比2018年的56.75亿美元下降4.35%。

目前，集成电路行业的常用封装主要包括BGA封装、BQFP封装、碰焊PGA封装等在内的40余种封装类型，其中只有极少数运用除塑料封装之外的陶瓷和金属封装，塑料封装占整个封装行业市场规模的90%以上，而陶瓷和金属封装合并占比在10%左右。根据目前的集成电路封装材料行业发展来看，超过9成的封装材料都是用的塑料封装，因此塑料封装市场规模占比在90%左右。根据中国封装工艺过程中封装材料成本占比为15%计算，集成电路塑料封装材料市场规模2019年为51亿元左右。近年来环氧树脂塑封料以其高可靠性、低成本、易规模生产等特点，在电子封装领域得到快速发展，已占据97%以上市场份额，而功能填料作为芯片封装材料的关键材料之一，其市场需求持续稳定增长。受益于物联网、人工智能、新一代显示技术以及国产CPU和存储器等新应用市场所带来的市场机遇，封测技术也在过去的几年里不断向前发展。本土龙头企业长电科技、华天科技和通富微电子更是全都进入全球前十，并在先进封装关键技术方面不断突破。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工业和信息化部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国半导体行业协会封装分会、51行业报告网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资

料，对中国集成电路封装及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代技术、发展趋势、新技术等进行了分析，并重点分析了中国集成电路封装行业发展状况和特点，以及中国集成电路封装行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的集成电路封装行业发展态势作了详细分析，并对集成电路封装行业进行了趋向研判，是集成电路封装经营、开发企业，服务、投资机构等单位准确了解目前集成电路封装业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一章 中国集成电路封装行业发展背景 1

第一节 集成电路封装行业定义及分类 1

一、集成电路封装行业定义 1

二、集成电路封装行业产品大类 1

三、集成电路封装行业特性分析 2

1、行业周期性 2

2、行业区域性 4

3、行业季节性 5

四、集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析 5

第二节 集成电路封装行业发展环境分析 6

一、行业管理体制 6

二、行业相关政策 6

三、宏观经济趋势 9

1、中国gdp增长情况分析 9

2、中国cpi波动情况分析 10

3、居民人均收入增长情况分析 11

4、经济环境影响分析 13

四、集成电路封装技术演进 22

五、集成电路封装形式应用领域 23

六、集成电路封装工艺流程 23

七、集成电路封装行业新技术动态 26

第二章 中国集成电路产业发展分析 28

第一节 集成电路产业发展状况 28

一、集成电路产业链简介 28

二、集成电路产业发展现状 29

三、集成电路产业市场规模 30

四、集成电路产业市场结构 30

1、集成电路市场产品结构 30

2、集成电路市场应用结构 32

五、集成电路市场竞争格局 32

六、集成电路产业区域发展格局 33

七、集成电路产业面临的发展机遇 34

八、集成电路产业面临的主要问题 35

第二节 集成电路设计业发展状况 35

一、集成电路设计业发展概况 35

二、集成电路设计业市场规模 36

三、集成电路设计业产业特征 37

四、集成电路设计业竞争格局 37

五、集成电路设计业发展趋势 38

六、集成电路设计业发展思路和政策建议 40

第三节 集成电路制造业发展状况 42

一、集成电路制造业发展现状 42

二、集成电路制造业发展特点 43

三、集成电路制造业发展规模 44

四、集成电路制造业财务指标 45

五、集成电路制造业供需平衡 45

1、全国集成电路制造业供给情况 45

2、全国集成电路制造业需求情况 46

3、全国集成电路制造业产销率 46

第三章 中国集成电路封装行业整体运行指标分析 47

第一节 中国集成电路封装行业整体发展情况 47

一、集成电路封装行业发展现状 47

二、集成电路封装行业发展特点 47

三、集成电路封装行业利润水平 48

四、大陆厂商与业内领先厂商的技术比较 48

第二节 2021-2026年中国集成电路封装行业总体分析 49

一、企业数量结构分析 49

二、人员规模状况分析 51

三、行业资产规模分析 51

四、行业市场规模分析 51

第三节 2021-2026年中国集成电路封装行业财务指标 52

一、行业盈利能力分析 52

二、行业偿债能力分析 53

三、行业营运能力分析 53

四、行业发展能力分析 53

第四章 中国集成电路封装行业市场需求分析 54

第一节 计算机领域对行业的需求分析 54

一、计算机市场发展现状 54

二、集成电路在计算机领域的应用 54

三、计算机领域对行业需求的拉动 57

第二节 消费电子领域对行业的需求分析 58

一、消费电子市场发展现状 58

二、集成电路在消费电子领域的应用 58

三、消费电子领域对行业需求的拉动 64

第三节 通信设备领域对行业的需求分析 64

一、通信设备市场发展现状 64

二、集成电路在通信设备领域的应用 65

三、通信设备领域对行业需求的拉动 66

第四节 工控设备领域对行业的需求分析 66

一、工控设备市场发展现状 66

二、集成电路在工控设备领域的应用 68

三、工控设备领域对行业需求的拉动 69

第五节 汽车电子领域对行业的需求分析 69

一、汽车电子市场发展现状 69

二、集成电路在汽车电子领域的应用 69

三、汽车电子领域对行业需求的拉动 70

第六节 其他应用领域对行业的需求分析 70

第五章 中国集成电路封装技术发展分析 71

第一节 半导体封测技术分析 71

一、中国半导体行业发展概况 71

二、半导体行业景气预测 71

三、半导体封装技术分析 73

1、封装环节产值逐年成长 73

2、封装环节外包是未来发展趋势 73

第二节 集成电路封装类专利分析 73

一、专利分析样本构成 73

1、数据库选择 73

2、检索方式 74

二、封装类专利分析 74

1、专利公开年度趋势 74

2、国内外专利公开趋势对比 75

3、国内专利公开主要省市分布 75

4、ipc技术分类趋势分布 76

5、主要权利人分布情况 78

第三节 集成电路封装过程部分技术问题探讨 79

一、集成电路封装开裂产生原因分析及对策 79

1、封装开裂的影响因素分析 79

2、管控影响开裂的因素的方法分析 80

二、集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策 80

1、产生芯片弹坑问题的因素分析 80

2、预防芯片弹坑问题产生的方法 81

第六章 中国集成电路封装行业产品市场分析 84

第一节 集成电路封装行业bga产品市场分析 84

一、bga封装技术 84

二、bga产品主要应用领域 84

三、bga产品需求拉动因素 85

四、bga产品市场应用现状分析 86

五、bga产品市场前景展望 86

第二节 集成电路封装行业sip产品市场分析 86

一、sip封装技术 86

二、sip产品主要应用领域 86

三、sip产品需求拉动因素 87

四、sip产品市场应用现状分析 88

五、sip产品市场前景展望 89

第三节 集成电路封装行业sop产品市场分析 89

一、sop封装技术 89

二、sop产品主要应用领域 90

三、sop产品市场发展现状 90

四、sop产品市场前景展望 90

第四节 集成电路封装行业qfp产品市场分析 90

一、qfp封装技术 90

二、qfp产品主要应用领域 91

三、qfp产品市场发展现状 91

四、qfp产品市场前景展望 91

第五节 集成电路封装行业qfn产品市场分析 92

一、qfn封装技术 92

二、qfn产品主要应用领域 92

三、qfn产品市场发展现状 92

四、qfn产品市场前景展望 92

第六节 集成电路封装行业mcm产品市场分析 93

一、mcm封装技术水平概况 93

1、概念简介 93

2、mcm封装分类 93

二、mcm产品主要应用领域 93

三、mcm产品需求拉动因素 94

四、mcm产品市场发展现状 94

五、mcm产品市场前景展望 95

第七节 集成电路封装行业csp产品市场分析 95

一、csp封装技术水平概况 95

1、概念简介 95

2、csp产品特点 95

3、csp封装分类 96

二、csp产品主要应用领域 96

三、csp产品市场发展现状 96

四、csp产品市场前景展望 97

第八节 集成电路封装行业其他产品市场分析 98

一、晶圆级封装市场分析 98

1、概念简介 98

2、产品特点 99

3、主要应用领域 99

4、市场规模与主要供应商 100

5、前景展望 100

二、覆晶/倒封装市场分析 100

1、概念简介 100

2、产品特点 101

3、市场前景 102

三、3d封装市场分析 104

1、概念简介 104

2、封装方法 105

3、封装特点 107

4、发展现状与前景 108

第七章 集成电路封装行业市场竞争分析 111

第一节 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析 111

一、现有竞争者之间的竞争 111

二、上游议价能力分析 111

三、下游议价能力分析 112

四、行业潜在进入者分析 113

五、替代品风险分析 114

第二节 集成电路封装行业国际竞争格局分析 115

一、国际集成电路封装市场发展状况 115

二、国际集成电路封装市场竞争状况 115

三、国际集成电路封装市场发展趋势 117

四、跨国企业在华市场竞争力分析 117

第三节 集成电路封装行业国内竞争格局分析 118

一、国内集成电路封装行业竞争格局分析 118

二、国内集成电路封装行业集中度分析 119

1、行业销售收入集中度分析 119

2、行业利润集中度分析 119

3、行业工业总产值集中度分析 120

三、中国集成电路封装行业国际竞争力分析 120

第八章 2026-2031年集成电路封装行业领先企业经营形势分析 122

第一节 杭州士兰微电子股份有限公司 122

一、企业发展简况 122

二、企业经营情况 122

三、企业集成电路业务 123

四、企业业务扩张及融资渠道 123

五、企业竞争状况优劣势 124

六、企业最新发展动向 126

第二节 天水华天科技股份有限公司 128

一、企业发展简况 128

二、企业经营情况 129

三、企业集成电路业务 129

四、企业业务扩张及融资渠道 130

五、企业竞争状况优劣势 130

六、企业最新发展动向 131

第三节 威讯联合半导体(北京)有限公司 132

一、企业发展简况 132

二、企业经营情况 132

三、企业集成电路业务 132

四、企业竞争状况优劣势 132

五、企业最新发展动向 133

第四节 上海中芯国际集成电路制造有限公司 133

一、企业发展简况 133

二、企业经营情况 133

三、企业集成电路业务 134

四、企业业务扩张及融资渠道 135

五、企业竞争状况优劣势 135

六、企业最新发展动向 137

第五节 吉林华微电子股份有限公司 138

一、企业发展简况 138

二、企业经营情况 139

三、企业集成电路业务 139

四、企业业务扩张及融资渠道 140

五、企业竞争状况优劣势 140

六、企业最新发展动向 142

第六节 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 142

一、企业发展简况 142

二、企业经营情况 143

三、企业集成电路业务 143

四、企业竞争状况优劣势 143

五、企业发展动向 144

第七节 江苏长电科技股份有限公司 144

一、企业发展简况 144

二、企业经营情况 145

三、企业集成电路业务 145

四、企业业务扩张及融资渠道 146

五、企业竞争状况优劣势 146

六、企业最新发展动向 149

第八节 通富微电子股份有限公司 150

一、企业发展简况 150

二、企业经营情况 150

三、企业集成电路业务 151

四、企业业务扩张及融资渠道 152

五、企业竞争状况优劣势 152

六、企业最新发展动向 154

第九节 无锡华润安盛科技有限公司 158

一、企业发展简况 158

二、企业经营情况 158

三、企业集成电路业务 159

四、企业业务扩张及融资渠道 159

五、企业竞争状况优劣势 160

六、企业最新发展动向 163

第十节 江阴苏阳电子股份有限公司 163

一、企业发展简况 163

二、企业经营情况 164

三、企业集成电路业务 164

四、企业业务扩张及融资渠道 164

五、企业竞争状况优劣势 165

六、企业最新发展动向 165

第十一节 深圳赛意法微电子有限公司 165

一、企业发展简况 165

二、企业经营情况 166

三、企业集成电路业务 166

四、企业业务扩张及融资渠道 166

五、企业竞争状况优劣势 166

六、企业最新发展动向 167

第十二节 南通华达微电子集团有限公司 167

一、企业发展简况 167

二、企业经营情况 168

三、企业集成电路业务 168

四、企业业务扩张及融资渠道 168

五、企业竞争状况优劣势 169

六、企业最新发展动向 169

第十三节 深圳安博电子有限公司 170

一、企业发展简况 170

二、企业经营情况 170

三、企业集成电路业务 170

四、企业业务扩张及融资渠道 170

五、企业竞争状况优劣势 172

六、企业最新发展动向 173

第十四节 江苏新潮科技集团有限公司 173

- 一、企业发展简况 173
- 二、企业经营情况 174
- 三、企业集成电路业务 174
- 四、企业业务扩张及融资渠道 174
- 五、企业竞争状况优劣势 174
- 六、企业最新发展动向 175

第十五节 乐山无线电股份有限公司 175

- 一、企业发展简况 175
- 二、企业经营情况 176
- 三、企业集成电路业务 176
- 四、企业业务扩张及融资渠道 177
- 五、企业竞争状况优劣势 177
- 六、企业最新发展动向 177

第十六节 广东风华芯电科技股份有限公司 178

- 一、企业发展简况 178
- 二、企业经营情况 179
- 三、企业集成电路业务 180
- 四、企业业务扩张及融资渠道 180
- 五、企业竞争状况优劣势 181
- 六、企业最新发展动向 183

第十七节 深圳市汇聚新兴产业有限公司 184

一、企业发展简况 184

二、企业经营情况 184

三、企业集成电路业务 184

四、企业业务扩张及融资渠道 185

五、企业竞争状况优劣势 185

六、企业最新发展动向 186

第十八节 上海先进半导体制造股份有限公司 186

一、企业发展简况 186

二、企业经营情况 186

三、企业集成电路业务 187

四、企业业务扩张及融资渠道 187

五、企业竞争状况优劣势 188

六、企业最新发展动向 188

第十九节 深圳市矽格半导体科技有限公司 189

一、企业发展简况 189

二、企业经营情况 189

三、企业集成电路业务 189

四、企业业务扩张及融资渠道 189

五、企业竞争状况优劣势 190

六、企业最新发展动向 190

第二十节 智瑞达科技(苏州)有限公司 191

一、企业发展简况 191

二、企业经营情况 191

三、企业集成电路业务 192

四、企业业务扩张及融资渠道 192

五、企业竞争状况优劣势 192

六、企业最新发展动向 193

第二十一节 深圳电通纬创微电子股份有限公司 193

一、企业发展简况 193

二、企业经营情况 194

三、企业集成电路业务 194

四、企业业务扩张及融资渠道 195

五、企业竞争状况优劣势 195

六、企业最新发展动向 195

第二十二节 上海松下半导体有限公司 196

一、企业发展简况 196

二、企业经营情况 196

三、企业集成电路业务 196

四、企业业务扩张及融资渠道 196

五、企业竞争状况优劣势 197

六、企业最新发展动向 197

第二十三节 苏州晶方半导体科技股份有限公司 197

一、企业发展简况 197

二、企业经营情况 198

三、企业集成电路业务 199

四、企业业务扩张及融资渠道 199

五、企业竞争状况优劣势 200

六、企业最新发展动向 202

第二十四节 沛顿科技(深圳)有限公司 204

一、企业发展简况 204

二、企业经营情况 205

三、企业集成电路业务 206

四、企业业务扩张及融资渠道 208

五、企业竞争状况优劣势 210

六、企业最新发展动向 210

第二十五节 矽格微电子(无锡)有限公司 211

一、企业发展简况 211

二、企业经营情况 211

三、企业集成电路业务 211

四、企业竞争状况优劣势 211

五、企业最新发展动向 211

第二十六节 浙江东和电子科技有限公司 212

一、企业发展简况 212

二、企业经营情况 212

三、企业集成电路业务 213

四、企业业务扩张及融资渠道 213

五、企业竞争状况优劣势 213

第二十七节 气派科技股份有限公司 213

一、企业发展简况 213

二、企业经营情况 214

三、企业集成电路业务 215

四、企业业务扩张及融资渠道 215

五、企业竞争状况优劣势 217

六、企业最新发展动向 217

第二十八节 山东凯胜电子股份有限公司 218

一、企业发展简况 218

二、企业经营情况 218

三、企业集成电路业务 218

四、企业业务扩张及融资渠道 219

五、企业竞争状况优劣势 219

第二十九节 恒汇电子科技有限公司 220

一、企业发展简况 220

二、企业经营情况 220

三、企业集成电路业务 221

四、企业业务扩张及融资渠道 221

五、企业竞争状况优劣势 222

六、企业最新发展动向 223

第三十节 深圳市中洋田电子技术股份有限公司 224

一、企业发展简况 224

二、企业经营情况 224

三、企业集成电路业务 224

四、企业竞争状况优劣势 224

五、企业最新发展动向 224

第九章 2026-2031年集成电路封装行业前景及趋势预测 225

第一节 2026-2031年集成电路封装行业发展的影响因素 225

一、有利因素 225

二、不利因素 225

第二节 2026-2031年集成电路封装市场发展前景 227

一、2026-2031年集成电路封装市场发展潜力 227

二、2026-2031年集成电路封装市场发展前景 227

三、2026-2031年集成电路封装行业发展趋势 227

第三节 2026-2031年中国集成电路封装行业发展预测 230

一、2026-2031年中国集成电路封装市场规模预测 230

二、2026-2031年中国集成电路封装行业供给预测 231

三、2026-2031年中国集成电路封装行业需求预测 231

第四节 中国集成电路封装行业存在的问题及对策 232

一、中国集成电路封装行业存在的问题 232

二、集成电路封装行业发展的建议对策 233

第十章 2026-2031年集成电路封装行业投资价值评估分析 235

第一节 集成电路封装行业投资特性分析 235

一、集成电路封装行业进入壁垒分析 235

二、集成电路封装行业盈利因素分析 236

三、集成电路封装行业盈利模式分析 237

第二节 集成电路封装行业投融资情况 237

一、行业资金渠道分析 237

1、行业资金渠道类别 237

2、股权融资 239

二、固定资产投资分析 241

三、兼并重组情况分析 247

四、集成电路封装行业投资现状分析 247

第三节 中国集成电路产业投资基金 251

一、国家集成电路产业投资基金 251

1、大基金基本情况 251

2、大基金的重要意义 251

3、大基金一期投资情况 252

(1)投资企业梳理 252

(2)投资方式分析 252

(3)投资领域分析 253

(4)一期成果汇总 253

4、大基金二期投资动态 254

5、大基金取得的成效 255

6、大基金下一步的工作思路 257

二、芯片产业基金地方动态分析 257

三、推进中国芯片产业发展的投融资建议 263

1、鼓励发展集成电路产业风险和私募投资资本 263

2、积极参与海外收购，集中建立产业园 264

3、加强与国际资本合作，推动中国企业走出去 264

4、建设集成电路投融资平台，促进资本和产业的交流 265

第四节 2026-2031年集成电路封装行业投资机会 265

一、产业链投资机会 265

二、细分市场投资机会 266

1、市场细分策略的类型 267

2、市场细分策略的优点 268

三、重点区域投资机会 269

四、集成电路封装行业投资机遇 271

第五节 2026-2031年集成电路封装行业投资风险及防范 271

一、政策风险及防范 271

二、技术风险及防范 273

三、供求风险及防范 274

四、宏观经济波动风险及防范 274

五、关联产业风险及防范 276

六、产品结构风险及防范 278

七、其他风险及防范 279

第六节 中国集成电路封装行业投资建议 281

一、集成电路封装行业主要投资建议 281

二、中国集成电路封装企业融资分析 283

第十一章 集成电路封装行业案例分析研究 287

第一节 集成电路封装行业并购重组案例分析 287

一、集成电路封装行业并购重组成功案例分析 287

二、集成电路封装行业并购重组失败案例分析 291

三、经验借鉴 293

第二节 集成电路封装行业经营管理案例分析 294

一、集成电路封装行业经营管理成功案例分析 294

二、集成电路封装行业经营管理失败案例分析 298

三、经验借鉴 301

第三节 集成电路封装行业营销案例分析 303

一、集成电路封装行业营销成功案例分析 303

二、集成电路封装行业营销失败案例分析 305

三、经验借鉴 308

第十二章 集成电路封装行业发展战略研究 309

第一节 集成电路封装行业发展战略研究 309

一、战略综合规划 309

二、技术开发战略 310

三、业务组合战略 312

四、区域战略规划 314

五、产业战略规划 315

六、营销品牌战略 315

七、竞争战略规划 316

第二节 对中国集成电路封装品牌的战略思考 318

一、集成电路封装品牌的重要性 318

二、集成电路封装实施品牌战略的意义 319

三、集成电路封装企业品牌的现状分析 320

四、中国集成电路封装企业的品牌战略 321

五、集成电路封装品牌战略管理的策略 323

第三节 集成电路封装经营策略分析 327

一、集成电路封装市场细分策略 327

二、集成电路封装市场创新策略 328

三、品牌定位与品类规划 330

四、集成电路封装新产品差异化战略 344

第四节 集成电路封装行业发展战略研究 346

一、2026-2031年集成电路封装行业投资战略 346

1、发展型投资战略 346

2、稳定型投资战略 346

3、退却型投资战略 347

4、稳定性投资战略 347

二、2026-2031年细分行业投资战略 348

1、市场细分策略的类型 348

2、市场细分策略的优点 349

附录 351

第一节 《国家集成电路产业发展推进纲要》 352

一、国家集成电路产业发展推进纲要 352

二、工信部介绍《国家集成电路产业发展推进纲要》情况 358

三、《国家集成电路产业发展推进纲要》提出,加强集成电路知识产权的运用和保护 362

四、《国家集成电路产业发展推进纲要》纲要内容 363

五、《国家集成电路产业发展推进纲要》纲要解读 365

六、关于《推进纲要》的主要内容 366

七、关于《推进纲要》措施的几个亮点 368

第二节 集成电路行业政治法律环境(p) 370

一、行业管理体制分析 370

二、行业主要法律法规 370

三、集成电路行业标准 371

四、行业相关发展规划 371

1、集成电路行业国家发展规划 371

2、集成电路行业地方发展规划 377

五、政策环境对行业的影响 378

第三节 行业技术环境分析 380

一、集成电路技术分析 380

1、技术水平总体发展情况 380

2、我国集成电路行业新技术研究 380

二、集成电路技术发展水平 381

1、我国集成电路行业技术水平所处阶段 381

2、与国外集成电路行业的技术差距 381

三、集成电路技术发展分析 383

四、行业主要技术发展趋势 385

五、技术环境对行业的影响 387

图表目录

图表：2021-2026年国内gdp增长情况 10

图表：2021-2026年国内居民消费指数波动情况 11

图表：2021-2026年居民消费价格比上年涨跌幅度 11

图表：2021-2026年全国居民人均可支配收入及其增长速度 12

图表：制造业pmi指数(经季节调整) 13

图表：中国制造业pmi及构成指数(经季节调整) 14

图表：中国制造业pmi其他相关指标情况(经季节调整) 15

图表：非制造业商务活动指数(经季度调整) 15

图表：中国非制造业主要分类指数(经季节调整) 17

图表：中国非制造业其他分类指数(经季节调整) 17

图表：综合pmi产出指数(经季度调整) 18

图表：中国宏观经济核心指标预测 20

图表：典型的半导体封测可以划分为前段和后段工序 24

图表：ic封装前段工艺除检测外，主要包括磨片、切片、引线键合等等 25

图表：引线键合是封装工艺中最为关键的一步 25

图表：集成电路产业链结构 29

图表：年我国集成电路行业销售额及增速 30

图表：2021-2026年全球集成电路市场产品结构 31

图表：2021-2026年国内存储芯片行业市场规模及预测 31

图表：2021-2026年中国集成电路进出口额及变化情况 35

图表：中国集成电路设计业销售规模情况 36

图表：2021-2026年国内集成电路制造业发展规模情况(亿元) 45

图表：2021-2026年国内集成电路制造业供给规模情况 45

图表：2021-2026年国内集成电路制造业需求规模情况 46

图表：2021-2026年全国集成电路制造业产销量情况 46

图表：2021-2026年集成电路封装行业利润情况 48

图表：国内封测龙头采购设备的国产化均偏低 49

图表：2021-2026年企业数量情况 50

图表：2021-2026年中国集成电路封装行业市场规模情况 52

图表：2021-2026年主要盈利能力分析 52

图表：2021-2026年半导体集成电路封装行业偿债能力指标情况 53

图表：2021-2026年半导体集成电路封装行业营运能力 53

图表：2021-2026年半导体集成电路封装行业发展能力 53

图表：计算机市场营业收入情况 54

图表：2021-2026年全国规模以上通信设备制造业营业收入变化情况 65

图表：中国工控行业在全球占比较低(2021-2026年)迎向上拐点 67

图表：工控自动化设备市场规模及预测 67

图表：q1国内集成电路封装专利公开年度趋势 74

图表：国内外专利公开趋势对比 75

图表：2021-2026年国内专利公开主要省市分布 75

图表：专利权利人分布情况 78

图表：弹坑现象因果图 81

图表：bga 封装示意图及产品 84

图表：波控板设计框图 87

图表：波控板选用 sip 前后对照图 88

图表：sop封装市场规模情况 89

图表：chip-on-wafer-on-substrate (cowos) 工艺 105

图表：基于2.5d封装技术的一款sip芯片 107

图表：2021-2026年全球集成电路封测行业所在区域市场占有率. 115

图表：封测主要设备 116

图表：2021-2026年全球前十大封测企业 116

图表：全球集成电路封测行业竞争格局 118

图表：2021-2026年士兰微企业经营情况 123

图表：士兰微近些年融资明细 124

图表：2021-2026年华天科技企业经营情况 129

图表：2021-2026年中芯国际企业经营情况 134

图表：华微电子2021-2026年经营情况 139

图表：长电科技2021-2026年企业经营情况 145

图表：2021-2026年通富微电子经营情况 151

图表：通富微电子融资明细 152

图表：2021-2026年华润安盛经营情况 158

图表：华达微电子企业产品展示 168

图表：华达微电子业务板块情况 169

图表：2021-2026年风华高科企业经营情况 179

图表：交易概览 188

图表：电通微电企业2021-2026年经营情况 194

图表：电通微电融资明细 195

图表：晶方科技2021-2026年经营情况 199

图表：沛顿科技营业收入及增速 206

图表：气派科技2021-2026年经营情况(万元) 215

图表：公司主营业务收入按产品类别构成情况(万元) 215

图表：凯胜电子融资明细 219

图表：恒汇电子企业产品展示 221

图表：中国封装技术演变路径 229

图表：2026-2031年中国集成电路封装市场规模预测 231

图表：中国集成电路封装行业盈利发展因素 236

图表：2021-2026年集成电路行业封装测试产业投融资情况(起，%) 242

图表：集成电路封测行业投资情况 243

图表：大基金在半导体设备领域投资主要集中在部分龙头企业 252

图表：国家大基金一期投资领域分布情况：设备占比较小 253

图表：大基金二期规模超过2000亿元，预计能撬动社会资金规模6000亿元左右 255

图表：地方政府投向半导体产业基金情况 256

图表：重点支持龙头企业做大做强、产业聚集以及下游应用等方向 257

图表：集成电路封测行业投资机构阶段分布 284

图表：国家集成电路产业投资基金投资优质标的列示 285

图表：四种基本的品牌战略 326

图表：各地集成电路政策 378

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：208224

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20210422/208224.shtml>

在线订购：[点击这里](#)